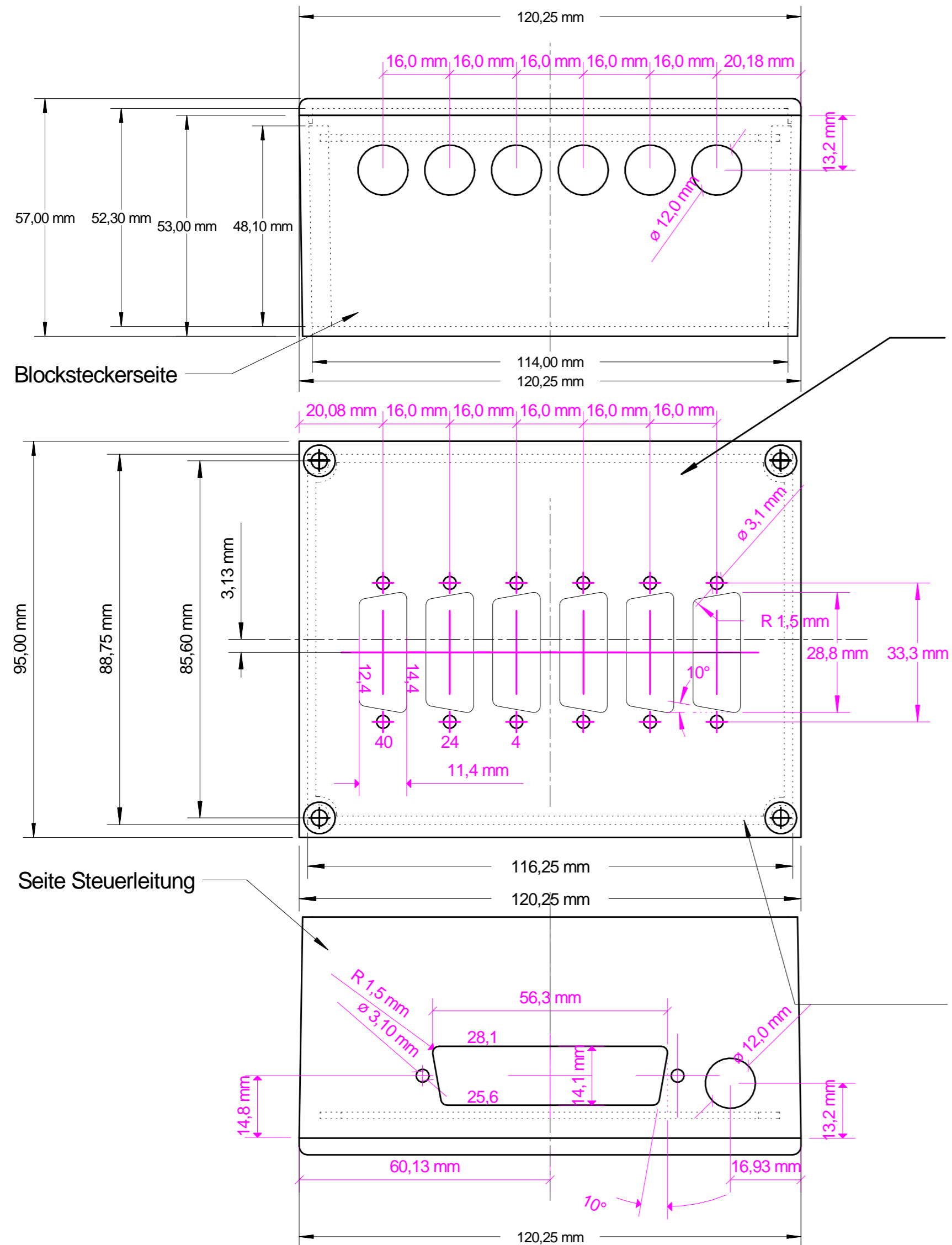
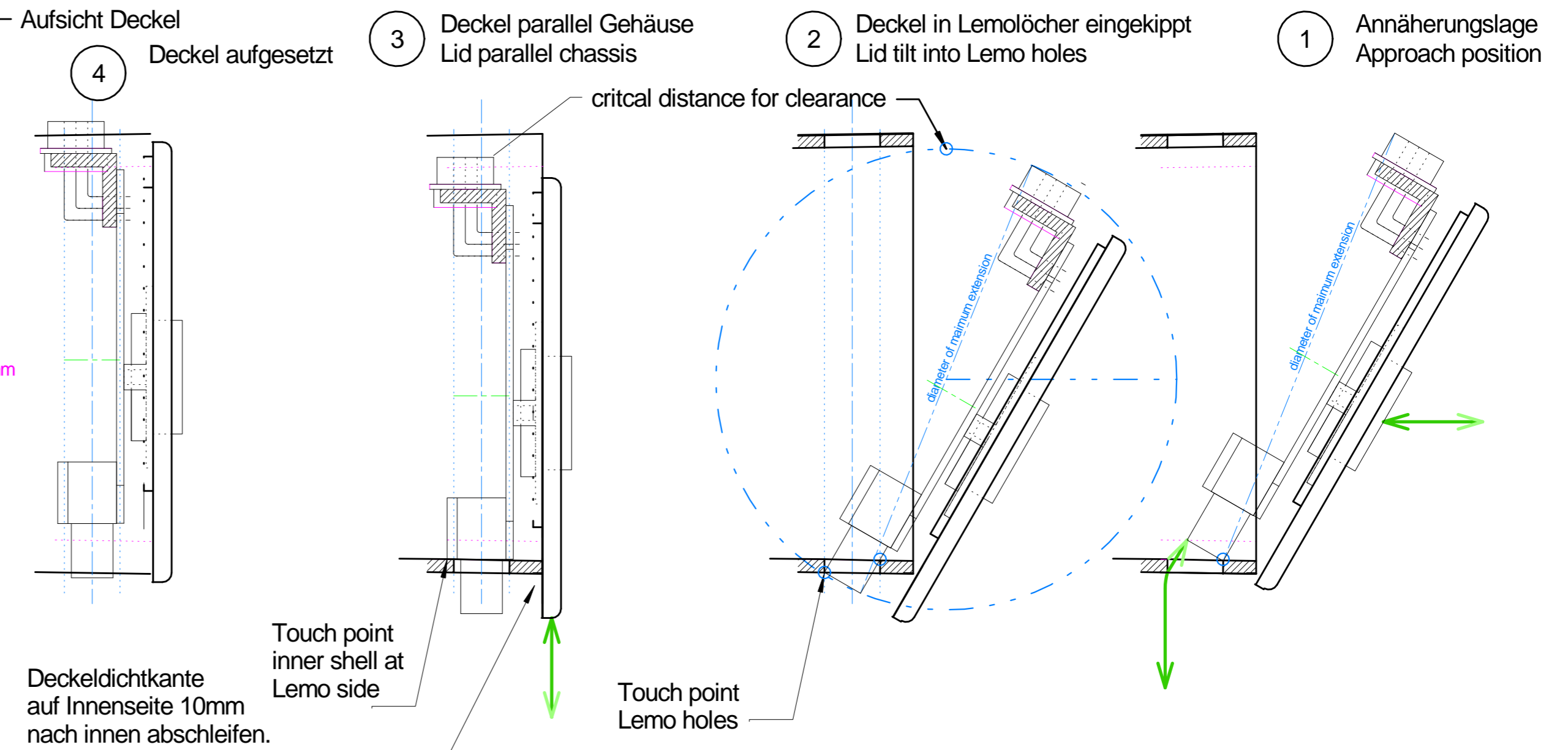


# Verteilerknoten "Sixfoldnode": Platine im Aluminiumgehäuse

## Signal node "Sixfoldnode": Board in aluminium chassis



Schema Platinen- und Deckeleinbringung  
Scheme for adding lid with board underneath



Deckeldichtkante auf Innenseite 10mm nach innen abschleifen.  
Remove sealing border at inner side 10 mm to middle!

Buchsen stehen beidseitig über Gehäusefront hinaus: Paltinen Einbringung erfordert Einkippen nach obigen Schema. Öffnen erfordert umgekehrte Verfahren (4. -> 1.): erster Schritt ist dann ein tieferes Ausfahren in Richtung der 6 Lemobuchsen, um dann den großen Sub-D-Stecker an der Gehäuse Innenwand vorbei schwenken zu können. Dieses erfordert die Entfernung der Deckeldichtkante auf dieser Seite!

Opening as shown in 3 is only possible along light green arrow path if sealing border at inner lid side has been milled away!